

## 令和 05 年度 (後期) 技能検定 学科試験正解

## 半導体製品製造／集積回路組立て作業【2級】

真偽法

番号	1	2	3	4	5
正解	×	○	×	○	×

番号	6	7	8	9	10
正解	×	○	×	○	×

番号	11	12	13	14	15
正解	×	×	○	×	×

番号	16	17	18	19	20
正解	×	×	○	○	○

番号	21	22	23	24	25
正解	○	○	○	×	○

択一法

番号	1	2	3	4	5
正解	□	イ	イ	イ	二

番号	6	7	8	9	10
正解	二	□	八	二	イ

番号	11	12	13	14	15
正解	八	イ	二	□	八

番号	16	17	18	19	20
正解	八	□	八	□	□

番号	21	22	23	24	25
正解	八	二	八	イ	イ